



## 12. HardCopy III デバイスの パッケージ情報

この資料は英語版を翻訳したもので、内容に相違が生じる場合には原文を優先します。こちらの日本語版は参考用としてご利用ください。設計の際には、最新の英語版で内容をご確認ください。

HIII51012-1.0

### はじめに

この章では、アルテラの HardCopy® III デバイスのパッケージ情報を提供しています。

### デバイスおよび パッケージ情報

表 12-1に、HardCopy IIIデバイスおよびパッケージ情報の一覧を示します。

デバイス	パッケージ	ピン
HC311W	FineLine BGA—ワイヤボンド	780
HC311F	FineLine BGA—フリップチップ	780
HC321W	FineLine BGA—ワイヤボンド	780
HC321F	FineLine BGA—フリップチップ	780
HC322L	FineLine BGA—フリップチップ	1152
HC322F	FineLine BGA—フリップチップ	1152
HC331W	FineLine BGA—ワイヤボンド	780
HC331F	FineLine BGA—フリップチップ	780
HC332L	FineLine BGA—フリップチップ	1152
HC332F	FineLine BGA—フリップチップ	1152
HC351W	FineLine BGA—ワイヤボンド	780
HC351F	FineLine BGA—フリップチップ	780
HC352L	FineLine BGA—フリップチップ	1152
		1517
HC352F	FineLine BGA—フリップチップ	1152
		1517
HC361W	FineLine BGA—ワイヤボンド	780
HC361F	FineLine BGA—フリップチップ	780

表 12-1.HardCopy III デバイスのパッケージ一覧 (2 / 2)

デバイス	パッケージ	ピン
HC362L	FineLine BGA—フリップチップ	1152
		1517
HC362F	FineLine BGA—フリップチップ	1152
		1517
HC372L	FineLine BGA—フリップチップ	1152
		1517
HC372F	FineLine BGA—フリップチップ	1152
		1517



HardCopy III デバイスの熱抵抗仕様は、「[HardCopy Series Device Thermal Resistance Data Sheet](#)」を参照してください。



HardCopy III デバイスのパッケージ形状は、アルテラ・ウェブサイトの「[デバイス・パッケージ詳細](#)」ページからダウンロードできます。

## 参考資料

この章では以下のドキュメントを参照しています。

- 「[Device Packaging Specifications](#)」
- 「[HardCopy Series Device Thermal Resistance Data Sheet](#)」

## 改訂履歴

表 12-2 に、本資料の改訂履歴を示します。

表 12-2.改訂履歴		
日付およびドキュメント・バージョン	変更内容	概要
2008 年 5 月 v1.0	初版	—